



#### ソルダーテールのシールド処理による EMI の軽減

このディスプレイ グラフィックス用 コネクタのソルダーテールは、伝送速度が 5.4 Gbps である為、露出した状態ではナイキスト周波数 2.7 GHz の EMI を発生させ、多くの無線通信周波数帯に干渉します。そこで、シールドが必要となります。図 1 に示したソルダーテールを覆う一体型のシールドカバーがディスプレイ グラフィックス コネクタの設計に組み込まれたことにより、デバイス ソリューションにおいてこの機能を付加する追加措置 (金属テープを貼付する、金属製カバーを別途グラフィックス コネクタに追加するなど)は不要となりました。



図 1. 一体型シールドを備えたグラフィックス用コネクタ

グランド フィンガーが、差動伝送方式で動作する各同軸線対間の 隔壁となります。これによって、以下の図 3 に青い矢印で示した最 短のグランド経路が実現します。



図 3. 平衡接続におけるシールドのグランド経路

これらのグランド フィンガーにより、差動伝送方式で動作する同軸伝 送線において平衡終端が実現するため、図4に示した信号のよう な差動データの高速伝送が可能となります。



図 4.2 つの極性を有する差動信号

終端が「不平衡」の場合、差動モードからコモン(同相) モードへの 変換量 (Scd21: 横方向変換損 (TCTL) として知られるノイズ) が増大し、EMI が発生します。図 5 は、陽極の静電容量が陰極の 静電容量を相殺する平衡終端を示したものです。 優れたグランド バ ー構造であれば、終端における Scd21 は一般に約-25dB となりま す。



図 5. 平衡伝送線

#### 平衡接続における終端部のグランド

この高速伝送用グラフィックス コネクタでは、差動伝送方式で動作 する同軸線の終端は、ファラデー ケージで覆われています。前処理 済みの同軸線の外部シールドを上下 2 枚のグランド バーで半田付 して、図 2 に示すように同軸線間の隙間(空隙)を完全に埋めること で頑丈なグランド バー構造を形成します。これによって、ケーブルが 引っ張られた際、中心導体とコネクタのプラグ ハウジングの接続部に おける機械的張力が緩和されます



図 2. ハウジング内の頑丈なグランド バー

#### 終端部のシールド処理

前処理済みのワイヤー アッセンブリーをプラグ ハウジングに結合した後、同軸線の終端部の上に上部金属シェルを取り付けます。



図 6. 終端部をシールドするプラグシェル

続いて、プラグ コネクタ アセンブリの上下両方でシェルをグランド バー に半田付けします。



図 7. グランドバーへのシェルの半田付け (上面図および底面図)

シールドのグランド経路は、同軸線シールドからコネクタ シェルを通じ てグランド バー、さらにプラグ シェルへとつながっています。プラグシェル は図 8 のとおりレセプタクル シェルと接しており、図 9 に示したレセプ タクル底部のグランド コンタクトの配置に沿って最短のグランド経路を 通っています。グランド経路が短いことにより、高速での優れた信号 伝達が可能となります。





図 9. レセプタクル シェル底部のグランド コンタクト

遮蔽蓋/板とソルダー テールの間の隙間は、短絡が発生しうる部位 と見なされていました。この設計(図 10)では、最低 1.7 mm のクリ アランスを絶対的に確保しています。



図 10. クリアランスによる短絡防止

CST Microwave Studio を使用して図 11 のとおり電界強度解 析を実施し、ソルダー テール部にシールドがある場合とない場合で、 このグラフィックス コネクタの電界放射を比較しました。



図 11. シミュレーションのセットアップ

シミュレーションは 3 箇所のレーンで行いました。解析されたのは、一方の端に近いピン 2 と 3 の位置、およびコネクタ中央付近のピン 20 と 21、そして 3 か所目はピン 8 と 9 の近くにあるシールド カバ ーのグランド フィンガー間です。シミュレーションのセットアップにおいて は、図 11 のとおり、GSSGSSGSS という伝送路配列を採用して います。

ソルダーテールを覆う一体型のシールト、をもつグラフィックス コネクタ と、ソルダーテール シールド カバーが無い状態の同コネクタで、20 GHz の高負荷信号を伝送した場合の電界強度の比較は、図 12 のとおりです。



図 12. 20GHz での電界シミュレーション

コネクタ上の3か所 (ピン20~21、2~3、グランドスプリング間) における電界シミュレーションについては、周波数2.4 GHz(約5 Gbps)の場合を図13に、5GHz (約10Gbps)の場合を図14 にて示しています。



このシミュレーションを見ると、ソルダー テールをシールドで覆った場合 には、 グラフィックス コネク タから電界は放射されないことがわかりま す。

データ伝送速度と周波数の関係は、「ナイキスト周波数」という用語 で説明されます。5.4 Gbps (HBR2) の場合のナイキスト周波数 は 2.7GHz であり、これは一部の LTE 事業者の周波数帯と同じ です。2.7 GHz 前後の LTE アンテナ送受信部に近接している 場合、ソルダー テールがシールドされていないグラフィックス コネクタ は、ナイキスト周波数約 2.7 GHz の電波を放射します。コネクタの ソルダー テールか らの放射 (ナイキスト周波数) と、2.7 GHz 前 後の LTE キャリア 周波数の間に発生する干渉は、通信回線の障 害の原因となります。さて、EMIの問題は解決しましたので、次に、 信号品位の性能解析を見てみましょう。時間領域で解析した特性 インピーダンス プロファイルと散乱パラメータ (S パラメータ) を使用し て、挿入損失、反射減衰量、遠端クロストーク、近端クロストーク、 および前述の差動モードからコモン モードへの変換特性 (Scd21) といったパラメータを周波数領域で解析します。図 11 に示した 3 つの差動レーンに対する解析では、共有可能な Touchstone 形 式の s12p ファイルが生成されます。

## グラフィックス コネクタのインピーダンスの連続性

このグラフィックス コネクタでは、優れたグランド 構造により、インピーダ ンスの不連続性を最小限に抑えながら eDP HBR2 (5.4 Gbps) での差動信号伝送を実現できます。5.4Gbps というデータ伝送速 度は一般に立ち上がり時間 Tr=64 ps (20%~80%) と同等と されますが、USB-IF がデータ伝送速度 10 Gbps に対し Tr=40ps (20%~80%) を推奨していることを踏まえ、この性能 解析では図 15 に示すとおり Tr=40ps (20%~80%) を使 用 しました。



Characteristic Impedance (Differential) Tr40psec 20-80%

図 15. インピーダンスの不連続性 (TDR 法)

このコネクタにおける 10 Gbps (5 GHz) でのインピーダンスの不連 続性は、平均して約 Δ10.2 オームです。この結果は、同コネクタが 優れた反射減衰量 (低反射) と優れたクロストーク特性 (高分離 性) を有することを示唆しています。伝送路のインピーダンス経路に 大きなばらつき (不連続性) がある場合は、反射減衰量およびクロ ストーク特性に問題が見られます。また、その場合、差動モードから コモン モードへの変換の悪化が予測されます。

## 挿入損失と反射減衰量 (s12p)

図 16 には、長さ 100 mm の終端処理済みケーブル (45 オーム に制御されたインピーダンスを有する細線同軸線 AWG38 を使用) における挿入損失を示しています。たとえば 5 Gbps (2.5 GHz) の場合、挿入損失は 2dB 未満です。



図 16. 100 mm のケーブルでのシミュレーション

図 17 に示した長さ 100 mm のケーブルにおける反射減衰量は、 -10dB よりも悪化した (12 GHz 超) 時点で許容不可能となりま す。ケーブル長が短いほど反射経路が短くなるため、反射減衰量が 劣ります。



図 17. 100 mm のケーブルでのシミュレーション

図 18 に示すこのケーブルにおけるクロストーク特性のシミュレーション でも、良好な結果が出ています。



図 18. 100 mm のケーブルにおけるクロストーク

ソルダーテールを覆う一体型シールト、ロックカバーを搭載した eDP グラフィックス用コネクタのデザインは、データ伝送速度が上昇し続け る中で、より高解像度のディスプレイ アッセンブリーをサポートできると いう点が特徴的です。

### 参考文献

- 1. I-PEX, "IER-001-07244-00," *Simulation Transmission*, January 15, 2016
- 2. I-PEX, "IER-001-06877-00," Grounding Bar Design, May 29, 2015.
- David E. Bockelman and William R. Eisenstadt, "Combined Differential and Common-Mode Scattering Parameters" IEEE Vol.43, No.7, July1955

Authored by Gregory A. Young, I-PEX Connectors

I-PEX および CABLINE は第一精工株式会社の商標です。その他すべての商標は、それぞれの企業に帰属します。

## 免責条項

ここに記載された製品の仕様は、予告なしに変更される場合があります。第 一精工株式会社は、これらの文書に記載された情報の正確性に責任を負 わず、また情報を更新する義務を負うものでもありません。



I-PEX Connectors 2305 Donley Drive, Suite 110 Austin, TX 78758 512-339-4739 www.i-pex.com

© DAI-ICHI SEIKO Co., Ltd. 2016. All rights reserved.